

SIPMOS® Small-Signal-Transistor

Features

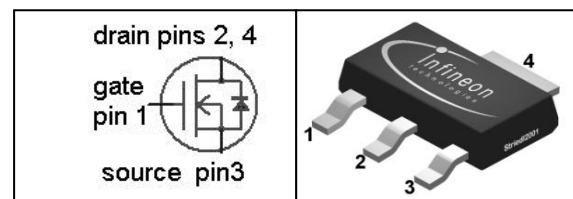
- N-channel
- Depletion mode
- dv/dt rated
- Available with $V_{GS(th)}$ indicator on reel
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



Product Summary

V_{DS}	600	V
$R_{DS(on),max}$	60	Ω
$I_{DSS,min}$	0.02	A

PG-SOT223



Type	Package	Tape and Reel Information	Marking	Packaging
BSP135	PG-SOT223	H6327: 1000 pcs/reel	BSP135	Non dry
BSP135	PG-SOT223	H6906: 1000 pcs/reel sorted in $V_{GS(th)}$ bands ¹⁾	BSP135	Non dry

Maximum ratings, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$T_A=25\text{ °C}$	0.12	A
		$T_A=70\text{ °C}$	0.10	
Pulsed drain current	$I_{D,pulse}$	$T_A=25\text{ °C}$	0.48	
Reverse diode dv/dt	dv/dt	$I_D=0.12\text{ A}$, $V_{DS}=20\text{ V}$, $di/dt=200\text{ A}/\mu\text{s}$, $T_{j,max}=150\text{ °C}$	6	kV/ μs
Gate source voltage	V_{GS}		± 20	V
ESD Class (JESD22-A114-HBM)			1A(>250V,<500V)	
Power dissipation	P_{tot}	$T_A=25\text{ °C}$	1.8	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}		-55 ... 150	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1			55/150/56	

¹⁾ see table on next page and diagram 11

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - soldering point (pin 4)	R_{thJS}		-	-	25	K/W
SMD version, device on PCB	R_{thJA}	minimal footprint	-	-	115	
		6 cm ² cooling area ²⁾	-	-	70	

Electrical characteristics, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Static characteristics

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=-3\text{ V}, I_D=250\text{ }\mu\text{A}$	600	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=3\text{ V}, I_D=94\text{ }\mu\text{A}$	-2.1	-1.4	-1	
Drain-source cutoff current	$I_{D(off)}$	$V_{DS}=600\text{ V},$ $V_{GS}=-3\text{ V}, T_j=25\text{ °C}$	-	-	0.1	μA
		$V_{DS}=600\text{ V},$ $V_{GS}=-3\text{ V}, T_j=125\text{ °C}$	-	-	10	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$	-	-	100	nA
On-state drain current	I_{DSS}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=10\text{ V}$	20	-	-	mA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=0.01\text{ A}$	-	30	60	Ω
		$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=0.12\text{ A}$	-	25	45	
Transconductance	g_{fs}	$ V_{DS} >2 I_D R_{DS(on)max},$ $I_D=0.1\text{ A}$	0.08	0.16	-	S

Threshold voltage $V_{GS(th)}$ sorted in bands³⁾

J	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=3\text{ V}, I_D=94\text{ }\mu\text{A}$	-1.2	-	-1	V
K			-1.35	-	-1.15	
L			-1.5	-	-1.3	
M			-1.65	-	-1.45	
N			-1.8	-	-1.6	

²⁾ Device on 40 mm x 40 mm x 1.5 mm epoxy PCB FR4 with 6 cm² (single layer, 70 μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical in still air.

³⁾ Each reel contains transistors out of one band whose identifying letter is printed on the reel label. A specific band cannot be ordered separately.

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic characteristics

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = -3 \text{ V}, V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	-	98	146	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	8.5	13	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	3.4	5.1	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 300 \text{ V}, V_{GS} = -3 \dots -5 \text{ V}, I_D = 0.1 \text{ A}, R_G = 6 \Omega$	-	5.4	8.1	ns
Rise time	t_r		-	5.6	8.4	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	28	42	
Fall time	t_f		-	182	273	

Gate Charge Characteristics

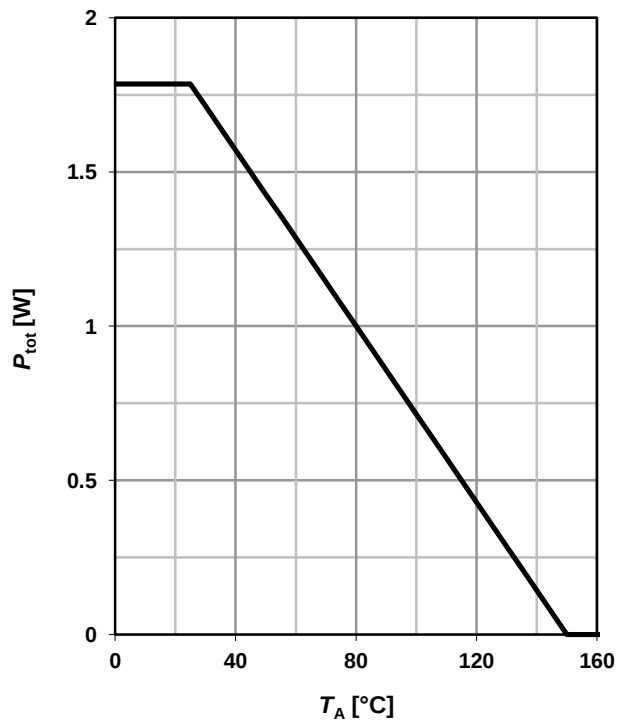
Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD} = 400 \text{ V}, I_D = 0.1 \text{ A}, V_{GS} = -3 \text{ to } 5 \text{ V}$	-	0.24	0.36	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	2.0	3.0	
Gate charge total	Q_g		-	3.7	4.9	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	0.20	-	V

Reverse Diode

Diode continuous forward current	I_S	$T_A = 25 \text{ °C}$	-	-	0.12	A
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$		-	-	0.48	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS} = -3 \text{ V}, I_F = 0.12 \text{ A}, T_J = 25 \text{ °C}$	-	0.78	1.2	V
Reverse recovery time	t_{rr}	$V_R = 300 \text{ V}, I_F = 0.1 \text{ A}, di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$	-	87	130	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	70	104	nC

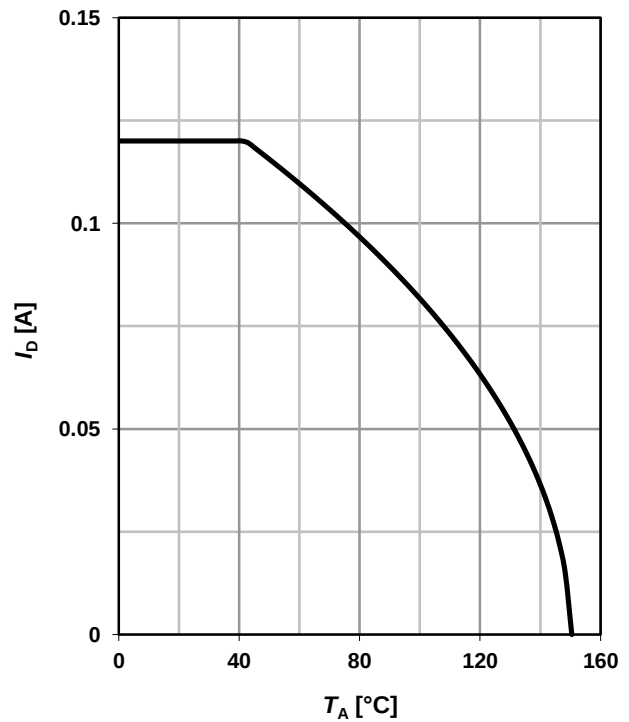
1 Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



2 Drain current

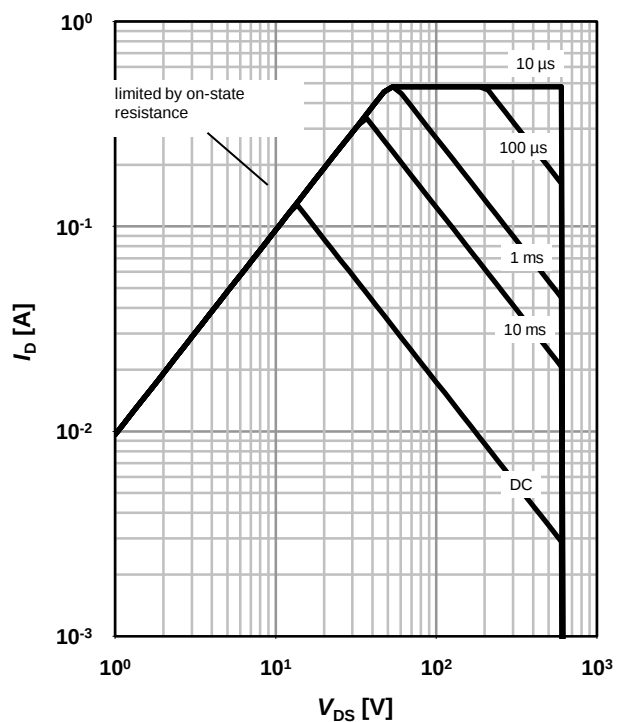
$$I_D = f(T_A); V_{GS} \geq 10 \text{ V}$$



3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS}); T_A = 25^\circ\text{C}; D = 0$$

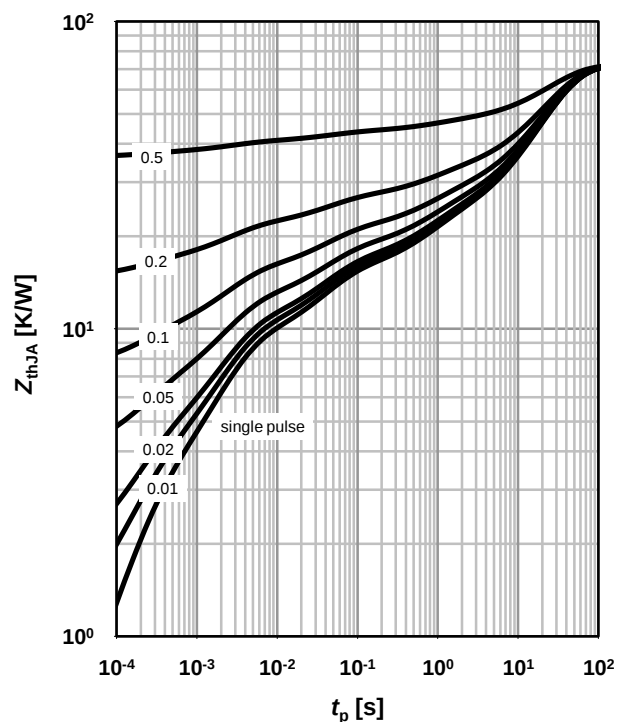
parameter: t_p



4 Max. transient thermal impedance

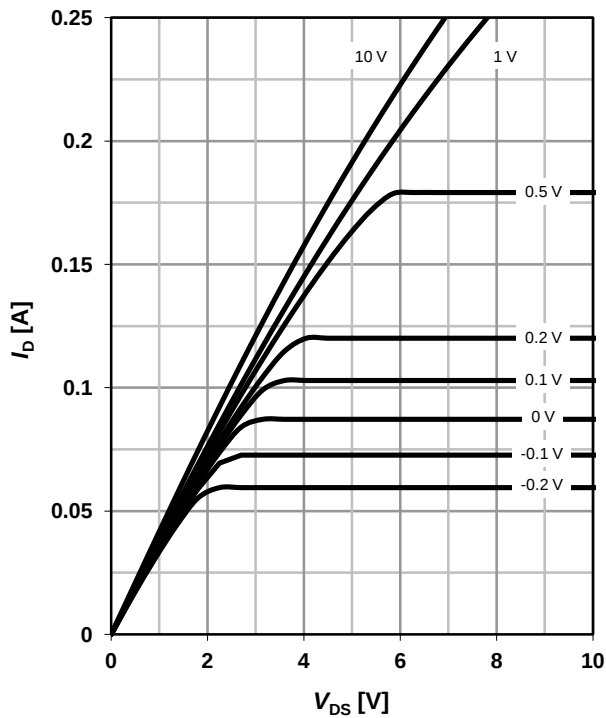
$$Z_{thJA} = f(t_p)$$

parameter: $D = t_p/T$



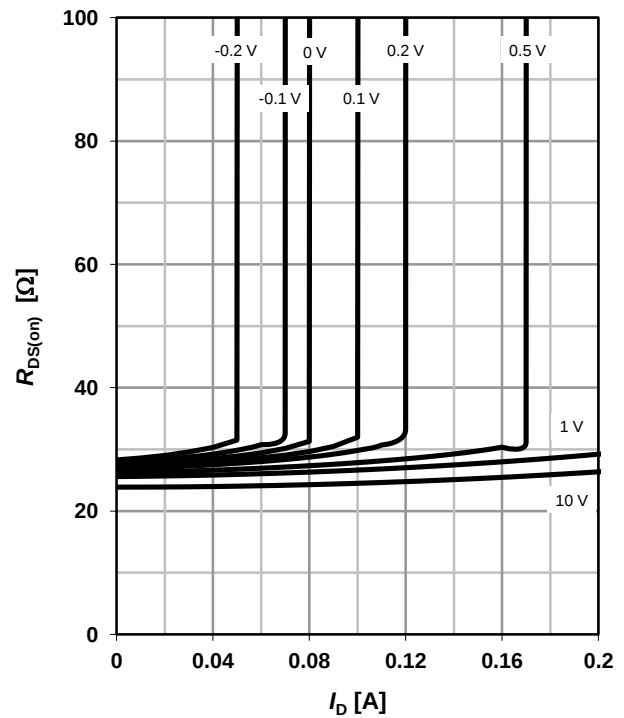
5 Typ. output characteristics

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$

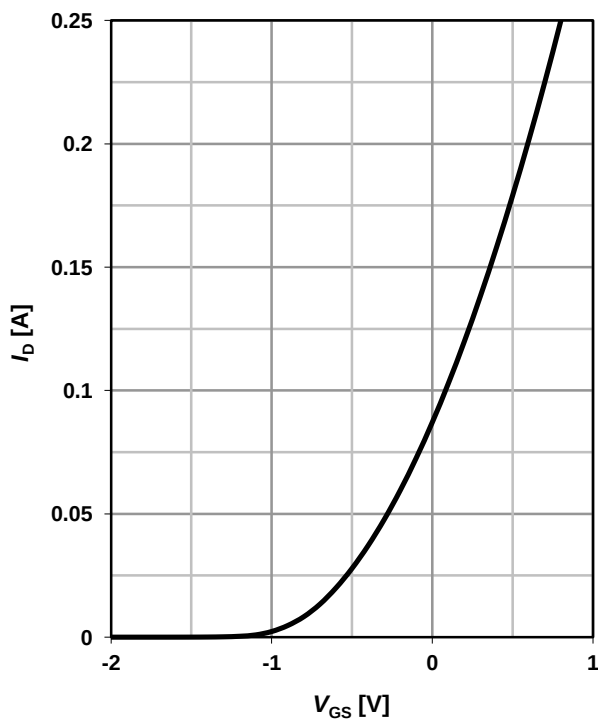
parameter: V_{GS}


6 Typ. drain-source on resistance

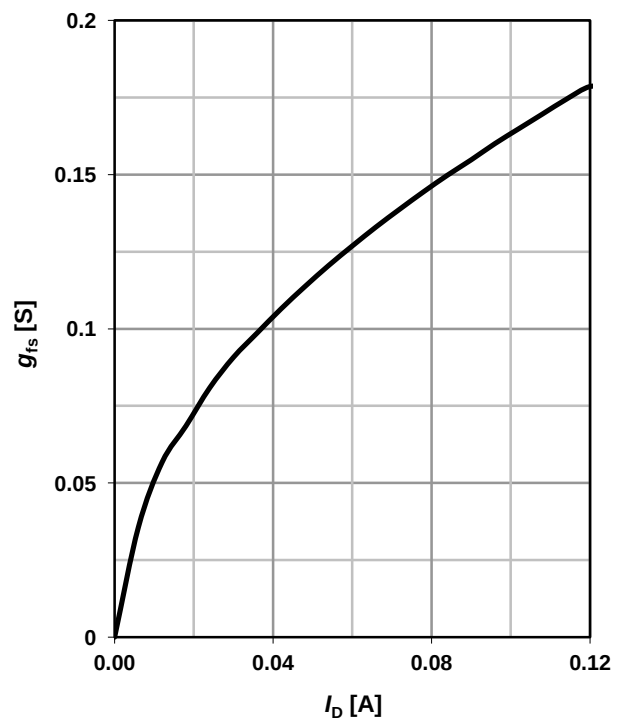
 $R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$

parameter: V_{GS}


7 Typ. transfer characteristics

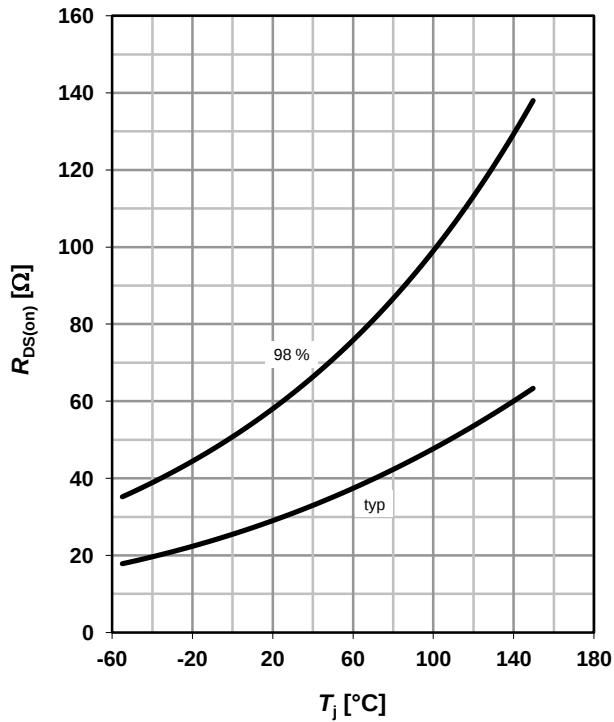
 $I_D = f(V_{GS}); |V_{DS}| > 2|I_D|R_{DS(on)max}$


8 Typ. forward transconductance

 $g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$


9 Drain-source on-state resistance

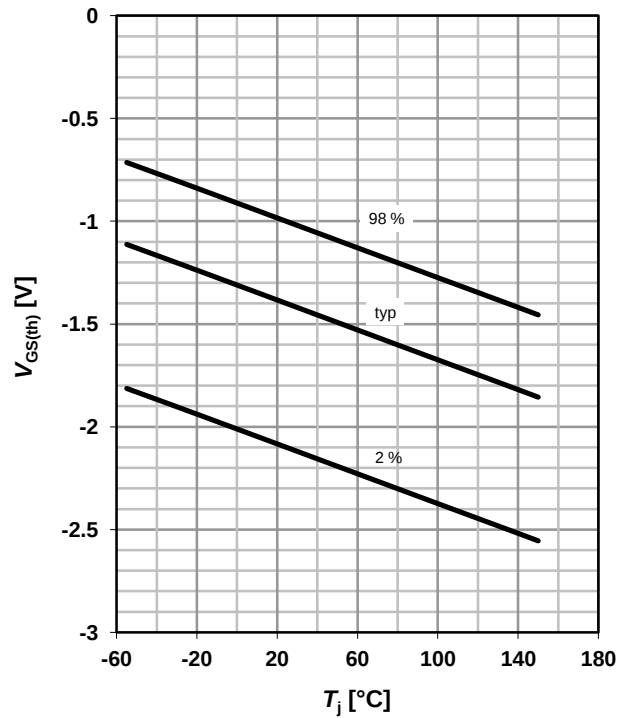
$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 0.01 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$$



10 Typ. gate threshold voltage

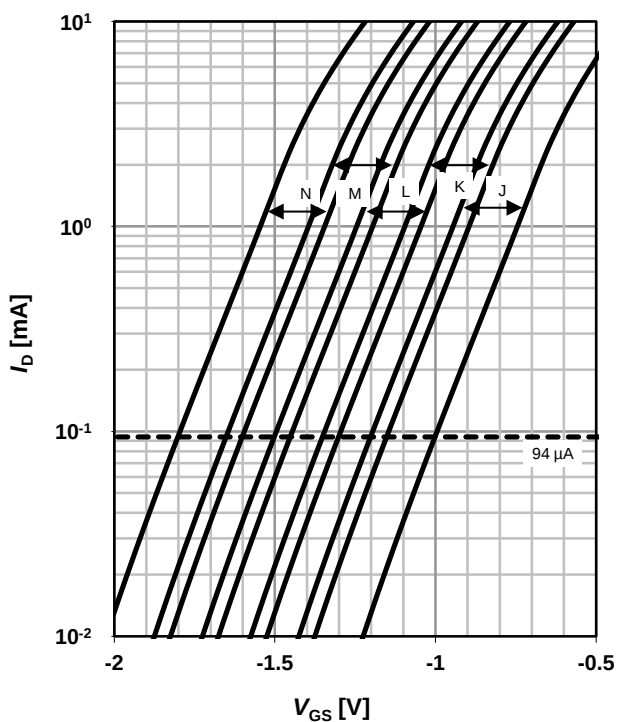
$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{DS} = 3 \text{ V}; I_D = 94 \text{ } \mu\text{A}$$

parameter: I_D



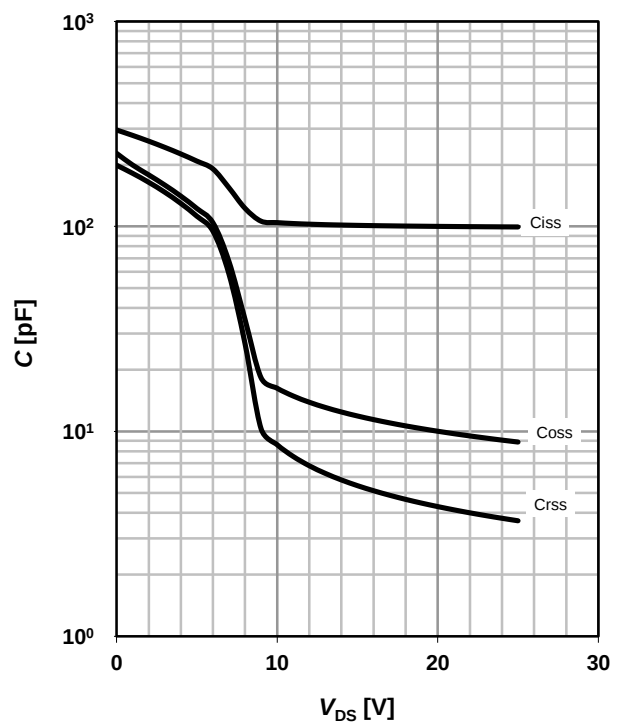
11 Threshold voltage bands

$$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 3 \text{ V}; T_j = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$$



12 Typ. capacitances

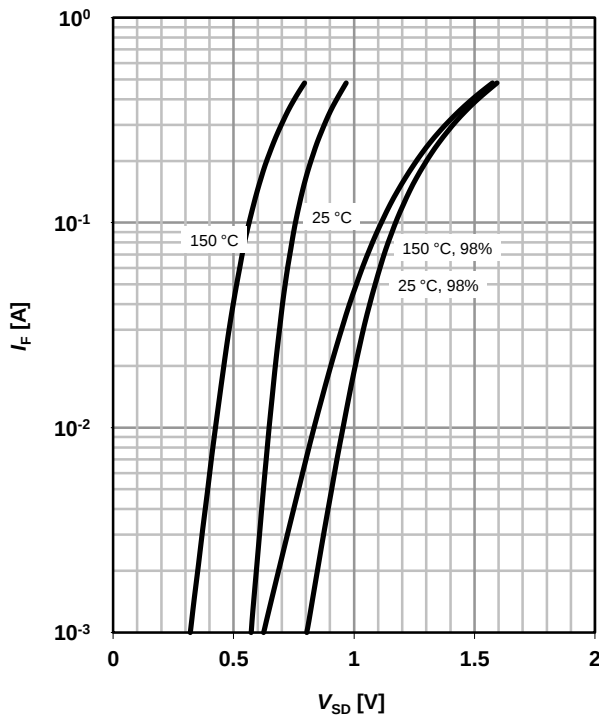
$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = -3 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$$



13 Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$

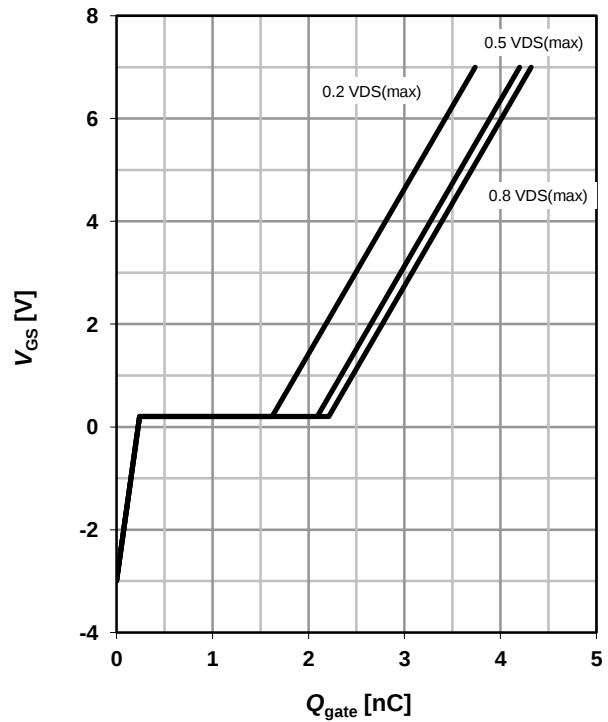
parameter: T_j



15 Typ. gate charge

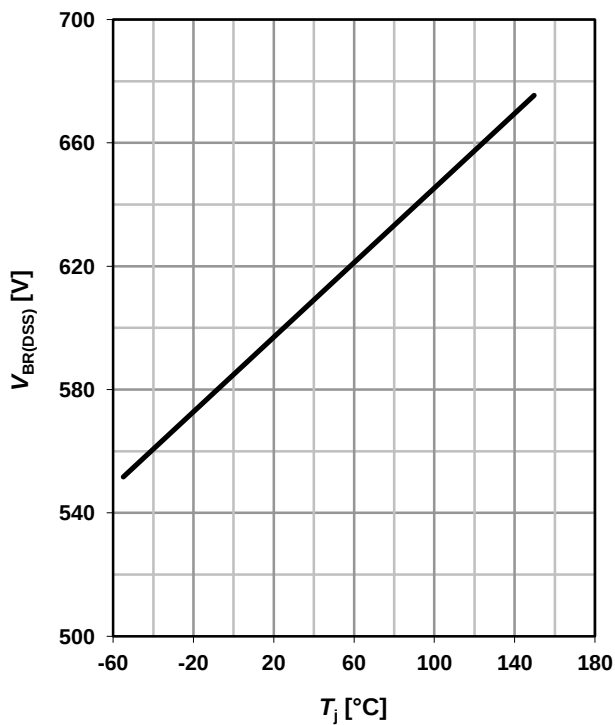
$$V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 0.1\text{ A pulsed}$$

parameter: V_{DD}



16 Drain-source breakdown voltage

$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$$



Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions and tolerances.

Front View Dimensions:

- Overall width: 6.5 ± 0.2
- Top flange width: 3 ± 0.1
- Top flange height: 4
- Bottom flange width: 4.6
- Bottom flange height: 0.7 ± 0.1
- Bottom flange thickness: 2.3
- Bottom flange width (inner): 0.7 ± 0.1
- Bottom flange width (outer): 4.6
- Bottom flange width (inner): 0.7 ± 0.1
- Bottom flange width (outer): 4.6

Side View Dimensions:

- Overall height: 7 ± 0.3
- Top flange width: 1.6 ± 0.1
- Top flange thickness: 0.1 max
- Top flange angle: 15° max
- Top flange height: 3.5 ± 0.2
- Top flange width (inner): 0.5 min
- Top flange width (outer): 0.28 ± 0.04

Surface Finish:

- Surface A: $\oplus 0.25 \text{ (M) A}$
- Surface B: $\equiv 0.25 \text{ (M) B}$

Material and Tolerances:

- Material: $+0.2 \text{ acc. to DIN 6784}$

Technical drawing of a stepped shaft with the following dimensions:

- Total length: 4.8
- Leftmost section diameter: 3.5
- Leftmost section width: 1.4
- Distance between first and second steps: 1.4
- Distance between second and third steps: 1.2
- Third section diameter: 1.1
- Third section width: 1.4

2012-11-29

Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2008 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please [contact the nearest Infineon Technologies Office \(www.infineon.com\)](http://www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А